

4月20日,沪硅产业成功登陆科创板,首日股价报收于10.91元/股,涨幅达180.46%,总市值为271亿元。

沪硅产业发行价为3.89元/股,募资规模24.12亿元。其成功登陆资本市场,对于国内芯片产业链具有重要意义。当前,我国半导体大硅片的供应高度依赖进口,沪硅产业着力攻克半导体大硅片的产业化难题,目前已实现300mm半导体硅片的本土化供应,打破了海外企业的垄断,推进了我国半导体关键材料生产技术“自主可控”的进程。公司拟通过上市募资进一步扩大产能,提升300mm半导体硅片国产化率。



制图/王力

沪硅产业科创板上市首日涨180%

着力提升半导体大硅片国产化率

□本报记者 杨洁

募资扩大产能

沪硅产业是一家半导体硅材料产业控股平台,成立于2015年,公司成立后快速完成了对新傲科技、上海新昇、芬兰Okmetic的整合,并作为第一大股东参股法国Soitec,在短时间内成为覆盖中国和欧洲的国际企业。

公司主要产品涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片。2019年前三季度,200mm及以下半导体硅片的营收占比在77%左右,300mm半导体硅片的营收占比在13%左右。

半导体硅片是芯片制造的重要材料,是集成电路大厦的基础,也是我国半导体产业链与国际先进水平差距最大的环节之一。当前全球半导体硅片行业市场集中度很高,主要被日本、德国、韩国、中国台湾等国家和地区的知名企业占据,全球前五大半导体硅片企业合计市场份额达93%。相较于行业前五大半导体硅片企业,沪硅产业的规模较小,占全球半导体硅片市场份额为2.18%。

目前,国际上300mm硅片主要终端应用为智能手机、PC、云计算、人工智能等领域;200mm硅片主要终端应用为汽车电子、物联网、工业电子等领域。随着半导体硅片不断向大尺寸的方向发展,未来300mm半导体硅片将作为主流尺寸。同时,100-150mm半导体硅片产能将逐步向200mm硅片转移,而200mm硅片产能将逐步向300mm硅片转移。

沪硅产业董事长俞跃辉介绍,中国大陆半导体硅片企业市场占比较小,技术较

为薄弱,多数企业以生产200mm及以下半导体硅片为主。沪硅产业是中国大陆率先实现300mm硅片规模化销售的企业,亦是大陆最大的半导体硅片企业之一。沪硅产业已成为中国少数具有一定国际竞争力的半导体硅片企业,产品得到了众多国内外客户的认可。

沪硅产业招股书显示,格罗方德、中芯国际、华虹宏力、华力微电子、华润微电子、长江存储、恩智浦、意法半导体等芯片制造企业已成为公司客户。

沪硅产业本次上市拟募集25亿元资金,主要用于集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化二期项目。项目实施后,公司将在现有15万片/月产能的基础上,增加到30万片/月产能。

受疫情影响有限

沪硅产业招股书显示,公司营收从2016年2.7亿元,快速增长到2019年的14.9亿元。但公司扣非归母净利润尚处亏损状态,主要系子公司旗下300mm半导体硅片生产线2016年至2017年处于产品的研发、试制及推广阶段,2018年下半年实现规模化生产,2019年仍处于持续投入期,该阶段产销规模低、固定资产折旧高等原因导致。公司预计,随着上海新昇规模效应进一步显现,沪硅产业将整体上实现扭亏为盈。

沪硅产业披露,截至2019年9月30日,公司拥有技术研发人员423人,拥有已获授权的专利340项。近三年,公司研发费用累计超过2.5亿元,研发费用占营业收入的平均比例约8%,这一比例处于行业

较高水平。

经初步预测,公司预计2020年一季度实现营业收入4亿元至4.42亿元,同比增长48.48%至64.10%,预计一季度实现归母净利润-4720万元至-6520万元,较上年同期下降5849.41万元至7649.41万元。

沪硅产业表示,公司300mm半导体硅片业务受半导体行业景气度下降的影响在2020年一季度仍然持续,产品平均销售价格较上年同期仍有下降;同时由于300mm半导体硅片2019年逆周期经营策略,公司持续进行机器设备投入,使得2020年一季度营业成本中因机器设备折旧、维护以及间接人工、能源等带来的固定费用较上年同期提高,因此300mm半导体硅片业务的预计亏损较上年同期大幅增加。

公司介绍,新冠肺炎疫情对公司影响有限。在原材料方面,公司主要境内供应商有研半导体材料有限公司、中环领先半导体材料有限公司等已复工,公司主要境外供应商Hemlock、瓦克集团、丸红株式会社、环球晶圆等位于美国、德国、日本与中国台湾地区,其生产经营目前未受疫情影响。同时,公司具有一定的原材料库存,公司原材料采购能够保证生产需求。疫情对公司原材料采购的影响可控。

在生产方面,沪硅产业及子公司已经复工,境外主要生产经营地位于芬兰,生产经营目前未受疫情影响。

在销售方面,沪硅产业的主要客户长江存储和武汉新芯位于湖北省,但疫情期间长江存储和武汉新芯并未停工,公司与上述客户的销售订单执行未受重大影响;

公司其余境内客户均已复工,主要境外客户博世、台积电、Soitec与Qorvo等位于德国、中国台湾地区、法国与美国,生产经营目前未受疫情影响。公司日常订单或重大合同的履行不存在明显障碍。

历时一年完成上市

回顾沪硅产业的科创板申请历程来看,公司在2019年4月提出科创板上市申请,选取了第四套上市标准:预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。期间历经四轮问询。2019年11月公司获得科创板上市委通过,2019年11月提交注册。不过,由于春节假期及疫情等多方面因素,直至今年3月17日公司才获得证监会同意注册的批复。

4月9日,沪硅产业正式开启网上网下申购,在回拨机制启动后,沪硅产业最终战略配售数量为1.42亿股,占发行总量的22.97%;网下发行数量3.43亿股,扣除战略配售后占比71.82%;网上发行数量1.35亿股,扣除战略配售后占比28.12%。

在股东方面,招股书显示,沪硅产业集团无控股股东和实际控制人。上海国资委100%持有的国盛集团和国家集成电路产业投资基金(简称“国家大基金”)为公司并列第一大股东,发行前持股比例为30.48%,之间不存在一致行动关系,分别提名了两位董事。半导体领域专业基金武岳峰IC基金和新微集团均持股8.71%,各提名一位董事。此外,嘉定开发集团持有公司9.37%股份,上市公司上海新阳持有7.51%股份。IPO后,国盛集团和国家大基金分别持股22.86%,依然并列大股东。

强化云服务 攻克AI 拓展海外

金山办公未来3至5年“三箭齐发”

□本报记者 熊永红 吴科任

下一步怎么走?这是摆在国产办公软件龙头——金山办公眼前的问题,也是投资者最为关心的话题之一。

在4月20日举行的2019年度业绩说明会上,金山办公董事长葛珂给出了他的答案。“从功能性向服务性转变。未来3至5年,我们会进一步强化云服务,人工智能是必须拿下的高地,更关注海外移动终端市场的拓展。”

值得一提的是,为加速战略执行,金山办公会考虑做一些投资并购。

疫情带来正反影响

疫情期间,受延时复工影响,各公司远程办公需求爆发式增加,金山文档表现不俗。2019年底,金山文档月度活跃用户数已有6700万,截至3月2日,其月度活跃用户数已经飙升到2.39亿(未与其他产品月度活跃用户进行排重),增长256%。“各类功能如表单和会议等的用户使用量也有较大增加。”金山办公总经理章庆元介绍,“过去一个月,海外的用户数提升较大,很多国家的日活、月活增长了60%至70%。”

葛珂表示,“随着疫情逐渐平缓或过去,金山文档的用户会有适当下滑,但从目前监测的数据看,用户数还非常稳定。疫情对基于云的协作办公会是一个用户快速普及的过程,当用户感受到云协作的优点后,像金山文档这类产品会有极长的生命力和发展空间,未来会更普及。”

章庆元预计,云办公逐渐增长的趋势不会因为疫情结束而改变,公司需要在产品协作上发力。“未来我们将不断提升跨端体验以及协同服务能力,使得个人用户云化程度

不断加大。金山文档是在线多人文档协作产品,目前还主要是免费形态。在产品层面,我们主要优化客户在协作、存储等方面体验,加大金山文档和WPS Office在产品层面的融合;云存储、云编辑的金山文档比单纯的工具用户黏性更高,未来会有更多的用户转化为付费客户。”

疫情加速在线办公用户教育过程的同时,葛珂坦言,疫情对金山办公也带来一定的负面影响,“主要是一季度正常的商务会谈和一些头部企业的预算延后,但我们相信公司整体趋势不会受到太大影响。”

财报显示,金山办公2019年实现业务收入15.80亿元,同比增长39.82%;归母净利润为4.01亿元,同比增长28.94%。其中,办公软件授权业务收入为4.96亿元,同比增长39.41%;办公服务订阅业务收入为6.80亿元,同比增长73.06%;互联网广告推广业务收入4.04亿元,同比增长5.99%。“目前看起来广告业务可能会受些影响”,葛珂说。

投入更多精力出海

金山办公积极“出海”,且业务保持快速增长。目前,WPS Office已经发布超46个语言版本,覆盖国家和地区超过220个;2019年10月,海外终端总月活跃用户超过1亿。2019年3月,公司在海外重点市场印度班加罗尔设立子公司,截至去年底,印度用户月活跃用户数达到3800万以上。2019年8月,公司发布WPS Office for Mac OS(个人版)国际版。泰国政府如司法部及当地第二大商业银行Tisco BANK已经开始规模采购WPS office软件。

章庆元认为,WPS在海外拓展成功有两个因素:一是中国手机在海外市占率的提升,公司与华为、OV等中国手机品牌厂商保

持了很好的合作关系;二是产品推出时间早,且金山办公的产品在创新上跟其他公司不同,“这是最重要的一点。在国际几家大厂中,我们最早做移动版,给了我们比较长的时间窗口。我们的产品也不一样,不是简单的把PC端搬到移动端,会根据手机场景做很多优化。”

章庆元介绍,2018年以前,WPS在海外没有进行大规模的预装推广,主要的量来自于自然下载,“这主要基于我们的移动端产品易用好用,体验比竞争对手要好。2018年以后,我们陆续和一些手机厂商进行预装合作,开始有意识地运营。我们相信,决定我们在海外拓展成功与否的核心还是我们的产品能否满足不同文化环境的人们本地化的特色办公需求。当然,在预装上,在运营和品牌上,我们也会针对不同的国家采用不同的策略。”

章庆元表示,海外市场策略有三个层次。一是印度、印尼等新兴互联网国家以提升月活为主要目标,盈利模式主要以“广告+付费会员”;二是欧美发达国家对服务订阅的接受度和付费意愿较高,会挑一些最有价值的C端服务,例如PDF转Word,在欧美进行输出;三是在“一带一路”国家,推进B端的一些销售。“目前我们在海外的规模还相对较小,还是希望以提高市占率、做用户数、做品牌为首要目标。未来可能投入比较大的精力把产品推到海外。”

投资注重协同效应

葛珂表示,在防范风险的情况下,会考虑通过投资并购方式去加速公司战略的执行和发展。“目前投资要做的一些工作已经开始,最近有几个项目也在开自己的投委会,我们也在密集跟一些投资机构或合作伙

伴匹配一些我们投的项目。今年开始,会继续有一些实质性的动作,也是希望充分利用好这个上市平台。”

葛珂强调,“我们是一家产品技术公司。上市前,我们就对投资并购就比较谨慎。过去几年,我们也投了一些项目,但这些项目跟WPS是息息相关的,有非常强的协同效应,要么在产品形态上,要么在服务形态上,又或者在收入形态上。我们会保持这样一个投资理念。另外一个新的技术方向,包括协同办公、云计算、AI等领域。能够进一步加速公司产品的完善度,提升平台的整合能力以及能够提升用户口碑和满意度的,都是考虑方向。”

在资本运作方面,葛珂还有一些深度思考:产品矩阵的思路在软件时代比较流行,在互联网时代不一定能取得效果。我们本身并不是BAT这样很大的平台,没有办法有这么强的协同作用。我们更加垂直,在有些产品上合作比投资更好。我们的思维方式是以已投的项目为例,是围绕文档和办公场景的一些小应用;以投的数科网维为例,是围绕信创生态的补充;未来,我们要做的还是围绕产品和内容的投资。

财报显示,金山办公上市后资金比较充裕,截至2019年底,货币现金余额为7.49亿元,交易性金融资产余额为55.36亿元。除项目投资外,葛珂介绍了账上资金的其他规划。“首先,我们的募投项目是实实在在的,我们也会按照严格按照募投资金管理的要求,在四个大的募投方向上进行投入。这些项目是奠定公司在办公领域内持续保持技术领先和研发优秀产品的基础。其次,在分红政策上,我们上市前有制定明确的分红规划。在公司利润健康、资金充足的情况下,会按照规划定期给股东进行分红。”

集成电路测试服务商 利扬芯片闯关科创板

□本报记者 刘杨

4月17日,广东利扬芯片测试股份有限公司(简称“利扬芯片”)科创板IPO申请获上交所受理。公司是国内知名芯片设计公司,提供中高端芯片独立第三方测试服务,主营业务包括集成电路测试方案开发、12英寸及8英寸等晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。

利扬芯片本次拟募资5.63亿元,用于芯片测试产能建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目等。公司表示,将坚持自主创新的发展道路,不断提高研发与创新能力,从而进一步提高在国内市场的占有率。同时,公司将努力加强品牌建设,致力于将公司发展成为国内领先、世界知名的集成电路测试服务商。

专注集成电路测试领域

根据招股说明书,利扬芯片是国内知名的独立第三方集成电路测试服务商。集成电路产业链主要包含芯片设计、晶圆制造、晶圆测试、芯片封装、芯片成品测试等主要生产环节。其中,晶圆测试和芯片成品测试是利扬芯片在集成电路产业链中所处的环节。

据介绍,自公司成立以来,利扬芯片在集成电路测试领域积累了多项自主的核心技术,已累计研发33大类芯片测试解决方案,可适用于不同终端应用场景的测试需求,完成超过3000种芯片型号的量产测试。

目前,公司自主研发设计的条状封装产品自动探针台、3D高频智能分类机械手等集成电路专用测试设备已运用到生产实践中。其产品主要应用于通讯、计算机、消费电子、汽车电子及工控等领域,工艺涵盖8nm、16nm、28nm等先进制程。

2017年至2019年,公司为汇顶科技、全志科技、国民技术、东软载波、博通集成、锐能微、比特微、西南集成、中兴微、智芯微、紫光同芯、集创北方、博雅科技、华大半导体、高云半导体等众多行业内知名的芯片设计企业提供测试服务。

在技术先进性方面,公司表示,一方面其具备为不同的芯片自主开发和设计集成电路测试方案的能力;另一方面公司通过对测试设备进行定制改进,以适应测试方案,并完成大规模批量测试,解决测试准确性和效率成本问题。

截至招股说明书签署日,公司拥有75项专利、8项软件著作权。同时,公司针对核心技术持续增加专利申请,公司正申请且已受理的专利为36项,其中发明专利16项。

研发投入占比较低

财务数据显示,利扬芯片2017年至2019年营收分别为1.29亿元、1.38亿元、2.32亿元;同期对应的净利润分别为1946.30万元、1592.71万元、6083.79万元。

2017年至2019年,公司研发费用分别为1097.62万元、1256.03万元和2199.13万元,最近三年累计研发投入为4552.79万元;公司研发投入占营收的比例分别为8.49%、9.08%和9.48%。

截至2019年12月31日,公司共有研发与技术人员137人,员工总数为773人,研发与技术人员占公司员工总数的比例为17.72%。

据了解,集成电路行业对技术、工艺要求均较高,同行业可比公司的研发投入平均水平整体较高,2017年和2018年研发费用占比达到15.42%和13.78%。

公司表示,目前已在智能手机、指纹识别、智能卡、物联网、北斗导航、存储、MEMS、区块链、5G基站、汽车电子等领域研发出量产测试方案并取得测试优势。未来,公司将在AI、大数据、云计算等新的领域加大研发投入,并持续扩大产能。

不过,利扬芯片表示,测试方案因需求而异,是否符合市场要求具有一定的不确定性,未来公司如果在测试方案的研发上未能正确做出判断,在研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期,或者研发出的测试方案未能得到市场认可、研发进度不够及时,公司将面临研发失败的风险,前期的研发投入将难以收回。

此外,利扬芯片客户集中度较高。2017年至2019年,公司对前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为87.61%、77.04%和76.39%,虽然客户的集中度在逐年下降,但占比仍然较高。如果未来公司主要客户的经营情况、采购战略、资信状况等发生重大不利变化,或由于公司测试服务质量等自身原因流失主要客户,将对公司的经营产生不利影响。

发展空间广阔

业内人士指出,随着国民经济的快速发展、产业升级等对传统经济的深入改造及发达国家地区集成电路产业逐渐向发展中国家进行战略转移,芯片国产化的比例不断提升。国家现阶段要大力发展集成电路产业,明确了集成电路产业的电子核心产业地位,集成电路测试是其中关键的一环。未来,在国内集成电路产业发展的带动下,我国集成电路测试行业发展潜力巨大。

据记者了解,国内独立第三方集成电路测试起步较晚,目前可以规模化生产的专业集成电路测试企业数量较少。就目前而言,独立第三方测试占整个集成电路产业的比例仍然较小,独立第三方测试企业的规模也比较小,行业竞争并不激烈。但是,随着集成电路行业尤其是国内集成电路产业的发展,国内对于集成电路测试的需求将不断扩大,同时随着国家对独立第三方测试行业的认可和重视,集成电路测试行业将有着广阔的发展空间。

需要指出的是,集成电路行业存在发展波动的风险。我国集成电路产业在核心技术掌握与高端产品应用等方面仍然与世界先进水平存在明显的差距。集成电路市场规模可能因技术更迭不及时、产业升级受阻、终端客户需求下降等因素导致市场规模下降或增长放缓。

本次闯关科创板,公司拟募资5.63亿元用于芯片测试产能建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目等。公司表示,本次项目通过新建生产厂房来扩大公司集成电路测试产能,突破现有产能的限制,从而满足快速增长的市场需求,为公司顺利开拓新的市场提供动力。

由于国内集成电路整体起步晚于其他发达国家,集成电路测试行业存在着测试技术落后、经验不足,测试设备基本靠进口支撑等问题,国内部分高端芯片的测试需求流向了台湾或其他海外市场。公司表示,将坚持自主创新的发展道路,不断提高研发与创新能力,提升服务技术水平,从而进一步提高在国内市场的占有率。本次项目的实施扩大了公司的产能,规模效应有利于实现效率的提升和成本的把控,是公司积极布局市场的关键一步。